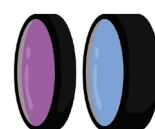
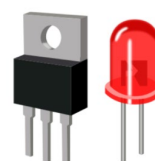
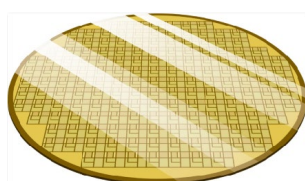


# 研究・開発・試作 光学・半導体・電子部品

## 受託蒸着・開発 【蒸着技術開発・薄膜開発・プロセス開発】

### 用途



各種条件	主要内容
主要プロセス	抵抗加熱 電子銃 イオンアシスト イオンプレーティング
加工膜厚	数 nm ~ 数 μm まで
積層可能数	1層~100層 2物質交互層可能
処理対象物	ガラス 樹脂 金属 Siウエハ GaAs など
蒸着条件	真空度 加熱温度 イオンクリーニング等 応相談

### メリット

スパッタ方式より、蒸着材料費・加工費用ともにコスト低減可能
スパッタ/メッキより、使用可能材料豊富
お客様希望条件にて加工実施
加工条件やプロセスなど情報開示可能

### 蒸着物質

無機物各種：酸化物/フッ化物/窒化物
金属等（毒物劇物/腐食物質等以外）
有機物（フッ素系撥水等）
その他、お客様希望の各種物質